



2022年2月15日

各 位

会 社 名	株式会社デンソー
代表者名	取締役社長 有馬 浩二
(コード番号 6902	東・名証第1部)
問合せ先	経 理 部 長 篠 田 吉 正
(TEL.	0566-63-2120)

## デンソーによる、JASM への少数持分出資についてのお知らせ

TSMC、ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社(以下「SSS」)、株式会社デンソー(以下「デンソー」)は、TSMCの半導体受託製造子会社で、TSMCが株式の過半を所有するJapan Advanced Semiconductor Manufacturing 株式会社(以下「JASM」)に対して、デンソーが約3.5億米ドル(約400億円\*)の少数持分出資を行うことを発表しました。この出資により、デンソーはJASMの10%超の株式を取得します。

JASMのファウンドリは、2022年(以下暦年)の建設開始を予定しており、2024年末までに生産開始を目指します。また、TSMCは市場ニーズに応えるため、既に公表済みの22/28nmプロセスに加えて、12/16nm FinFETプロセス技術による製造も担えるようJASMの能力を強化し、月間生産能力を55,000枚(300mmウェーハ)に増強する予定です。今回の生産能力増強に伴い、このファウンドリへの設備投資額は、約86億米ドル(約9,800億円\*)となる見込みで、日本政府からの強力な支援を受ける前提で検討しています。このファウンドリでは、約1,700名の先端技術に通じた人材の雇用創出を見込みます。

このJASMとデンソーにおける取引の完了は、一般的なクロー징条件を満たすことが条件となります。

なお、本出資がデンソーの2021年度通期の連結業績見通しに与える影響は軽微です。

\* 1米ドル=114円として計算

以 上